香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

GOLDSTREAM INVESTMENT LIMITED
金涌投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1328)

自願公告
認購CAPCON HOLDINGS LIMITED之股權

本公告由金涌投資有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)自願刊發，以向本公司之股東及潛在投資者披露本集團業務之最新發展情況。

認購事項

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，本公司近期以5,000,000美元(「**認購價**」)完成認購Capcon Holdings Limited(「**Capcon**」或「**華封科技**」)發行之B-4輪可轉換可贖回優先股(「**是次認購**」)。

本集團主要從事提供投資管理服務業務及策略直投業務。本集團恆常對具良好聲譽兼商業潛力的公司進行投資。本集團認為，Capcon作為先進半導體封裝設備研發和生產領域的產業領導者，符合集團的投資標準，並將為公司股東帶來價值。

本公司就是次認購所繳付之認購價，以現金支付及由本集團之內部資源撥付。

董事會認為，是次認購乃按公平合理之商業條款並在獨立協商基礎上訂立，屬公平合理，並符合本公司及全體股東之整體利益。

華封科技的資料

華封科技於2014年在中國香港創立，目前在新加坡、中國內地、中國臺灣地區設立業務、研發和生產製造基地，並且業務已佈局於形成全球化的運營網絡。

根據本公司的所得資料，華封科技是一家專注於半導體先進封裝設備研發與生產製造的高科技企業集團，於全球先進封裝領域內具備明顯技術優勢，被視為該領域的科技獨角獸，在相關技術及細分市場中位列全球領導者之列。

根據本公司的所得資料,華封科技全方位服務全球逾60家企業客戶。目前，華封科技為全球最大封測企業日月光集團(Advanced Semiconductor Engineering)晶圓級封裝工序之核心設備首選供應商。

華封科技匯聚在先進封裝領域具備深厚經驗的世界級專家團隊，核心技術涵蓋高精度高速率設備開發、關鍵設備突破及全流程工藝覆蓋，致力打造具備全球競爭力的先進封裝設備、整線解決方案及相關服務體系。

董事經作出一切合理查詢後所知悉、所獲資料及所信，華封科技及其最終實益擁有人均為獨立第三方，並非本公司或其任何關連人士(定義見《**上市規則**》)之關連人士。

上市規則之涵義

由於按《上市規則》第14.07條計算之所有適用百分比率均低於5%，是次認購不構成本公司於《上市規則》第十四章所述之須予公告交易。

承董事會命
金涌投資有限公司
主席
趙令歡先生

香港，2025年11月11日

於本公告日期，董事會由兩位執行董事，分別為趙令歡先生(主席)及高子奇先生(首席執行官)；一位非執行董事，為譚仕英先生；以及四位獨立非執行董事，分別為靳慶軍先生、李建平先生、舒華東先生及葛新女士所組成。